

**2024年3月期**

# **第2四半期 決算説明**

**2023年11月9日**

**芝浦メカトロニクス株式会社**

## 目次

- 1. 2024年3月期 第2四半期 連結業績**
2. 2024年3月期 連結業績予想
3. 中期経営計画の進捗

## 業績サマリー

### ■ 売上高・利益

- 対前年 増収増益
- 売上高は計画通りに推移し 305億円  
SPE 前年比30%増収 (183億円 ⇒ 237億円)
- 営業利益は半導体前工程の売上増加などにより 50.2億円 (ROS 16.4%)
- 23年度業績は前回予想から上振れ見込み

### ■ 受注高

- 半導体前・後工程とも堅調で 333億円  
半導体前工程は顧客の設備投資時期の見直しなどにより前年に比べ減少、  
半導体後工程は前年下期に比べ大幅増加、全体として堅調に推移

### ■ 受注残高

- 2023年9月末 683億円

## 業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	22/上	22/下	23/上 実績	対前年 増減率
売上高	293	317	305	+4%
営業利益	46.0	63.1	50.2	+9%
R O S	15.7%	19.9%	16.4%	+0.7pt
経常利益	42.6	62.6	50.3	+18%
当期純利益	34.1	57.9	38.7	+13%
受注高	474	294	333	-30%
F C F	43.8	-11.9	46.3	+2.5億円

\* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

### ■ 売上高

前年比4%増収 (293億円 ⇒ 305億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増収

### ■ 営業利益

前年比9%増益 (46.0億円 ⇒ 50.2億円)

- 半導体前工程の売上増加により増益

### ■ 当期純利益

前年比13%増益 (34.1億円 ⇒ 38.7億円)

- 営業利益改善により増益

### ■ 受注高

前年比30%減少 (474億円 ⇒ 333億円)

- 顧客の設備投資時期の見直しなどにより減少

## セグメント別業績結果 (対前年) ①

### ■ ファインメカトロニクス部門

\* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比27%増 (186億円 ⇒ 236億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやウェーハ向けがいずれも順調で増加。  
FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比55%増 (32.0億円 ⇒ 49.7億円)

半導体前工程の売上増加により増益。

➤ 受注高 前年比44%減 (358億円 ⇒ 200億円)

半導体前工程では、全体として堅調に推移したものの、顧客の設備投資時期の見直しなどにより減少。  
FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

## セグメント別業績結果 (対前年) ②

### ■ メカトロニクスシステム部門

\*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比46%減 (86億円 ⇒ 47億円)  
半導体後工程では、全体として減少だが、先端パッケージ向けは堅調。  
FPD後工程では、前年度受注低調の影響により減少。  
真空部門では、半導体向けが堅調で増加。
- セグメント利益 前年比76%減 (15.0億円 ⇒ 3.6億円)  
半導体後工程とFPD後工程の売上減少が影響し減益。
- 受注高 前年比8%増 (95億円 ⇒ 103億円)  
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い 前年下期比 大幅増加。3Q以降の売上に寄与。  
FPD後工程では、市況の影響を受け大幅に減少。  
真空部門では、半導体向けを中心に順調に推移。

## 業績結果 (対前回見通し)

\*1: 2023年8月公表

(単位: 億円)

	23/上		
	前回見通し *1	実績	対前回見通し 増減率
売上高	290	305	+5%
営業利益	40.0	50.2	+25%
R O S	13.8%	16.4%	+2.6pt
経常利益	39.0	50.3	+29%
当期純利益	31.0	38.7	+25%
受注高	-	333	-

### ■ 売上高

前回見通し比5%増収 (290億円 ⇒ 305億円)

- SPE分野が順調に推移

### ■ 営業利益

前回見通し比25%増益 (40.0億円 ⇒ 50.2億円)

- 売上増加、経費減

### ■ 当期純利益

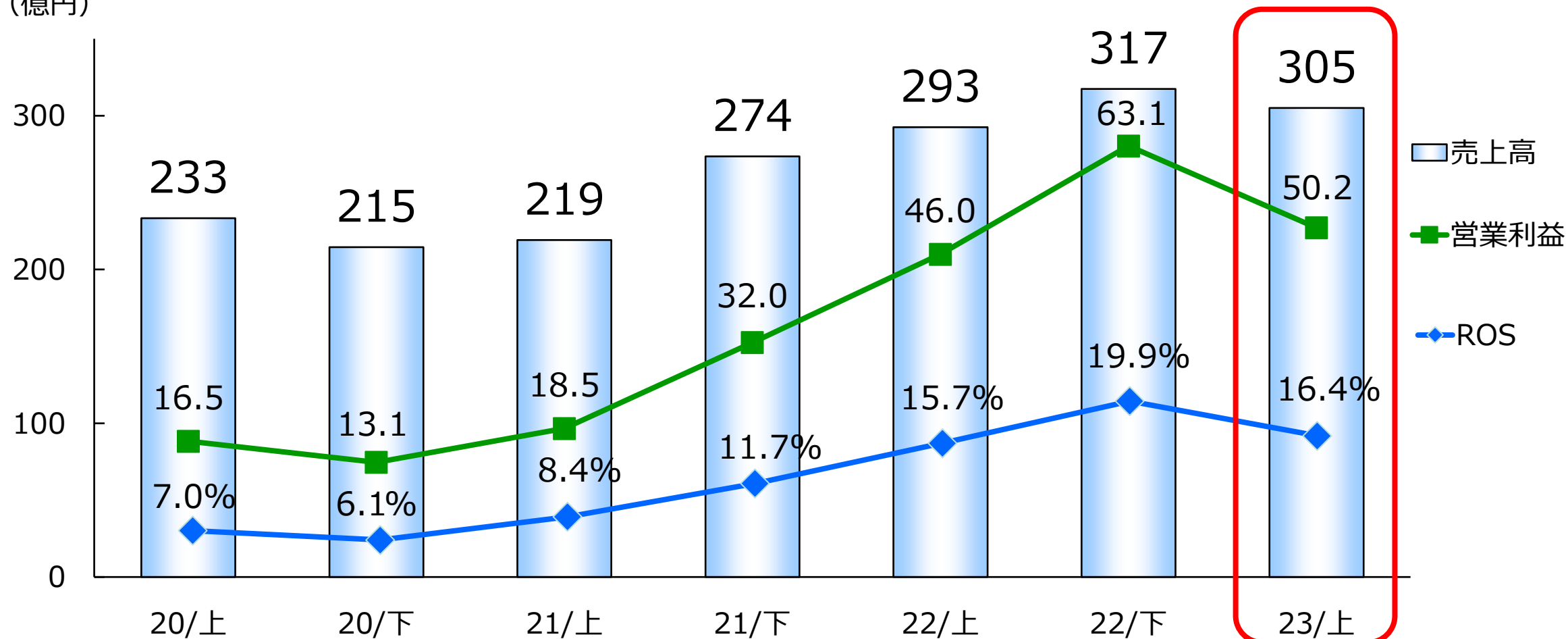
前回見通し比25%増益 (31.0億円 ⇒ 38.7億円)

- 営業利益改善による

## 売上高・利益・ROS

ROS16.4%

(億円)



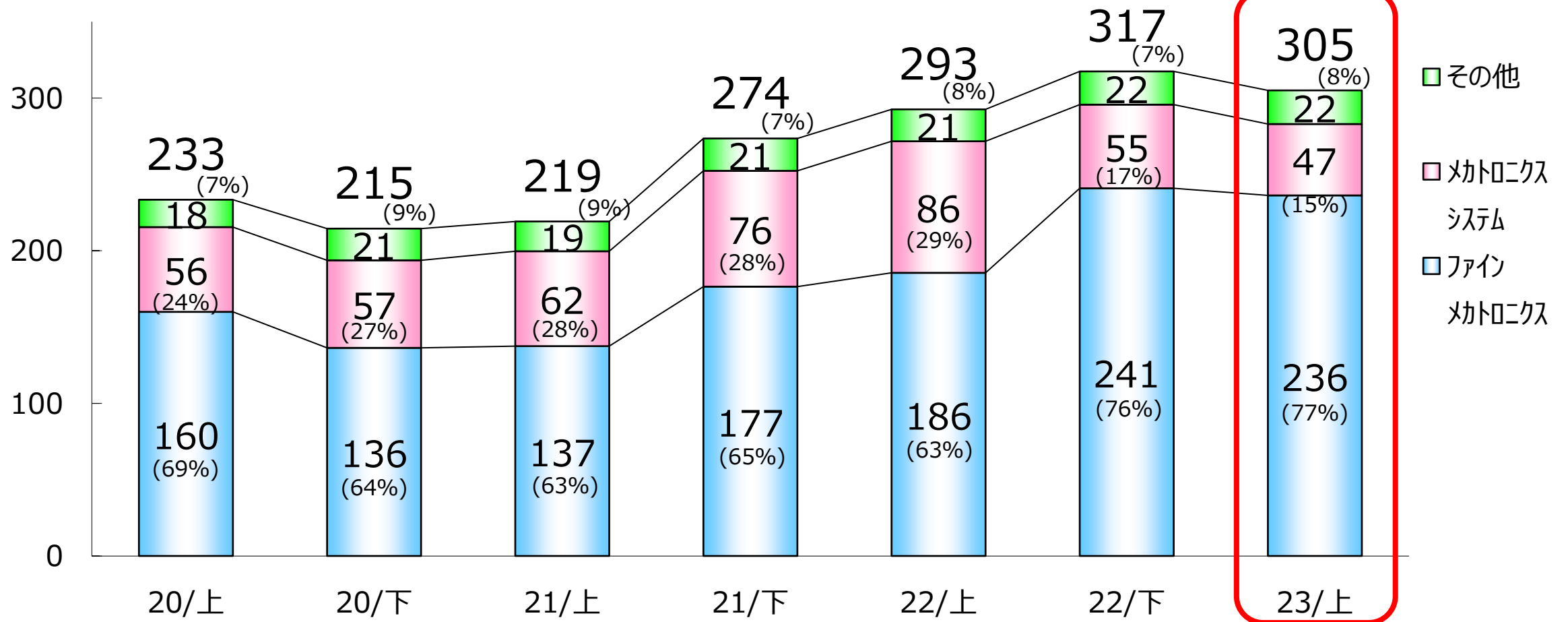


## セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 77%

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

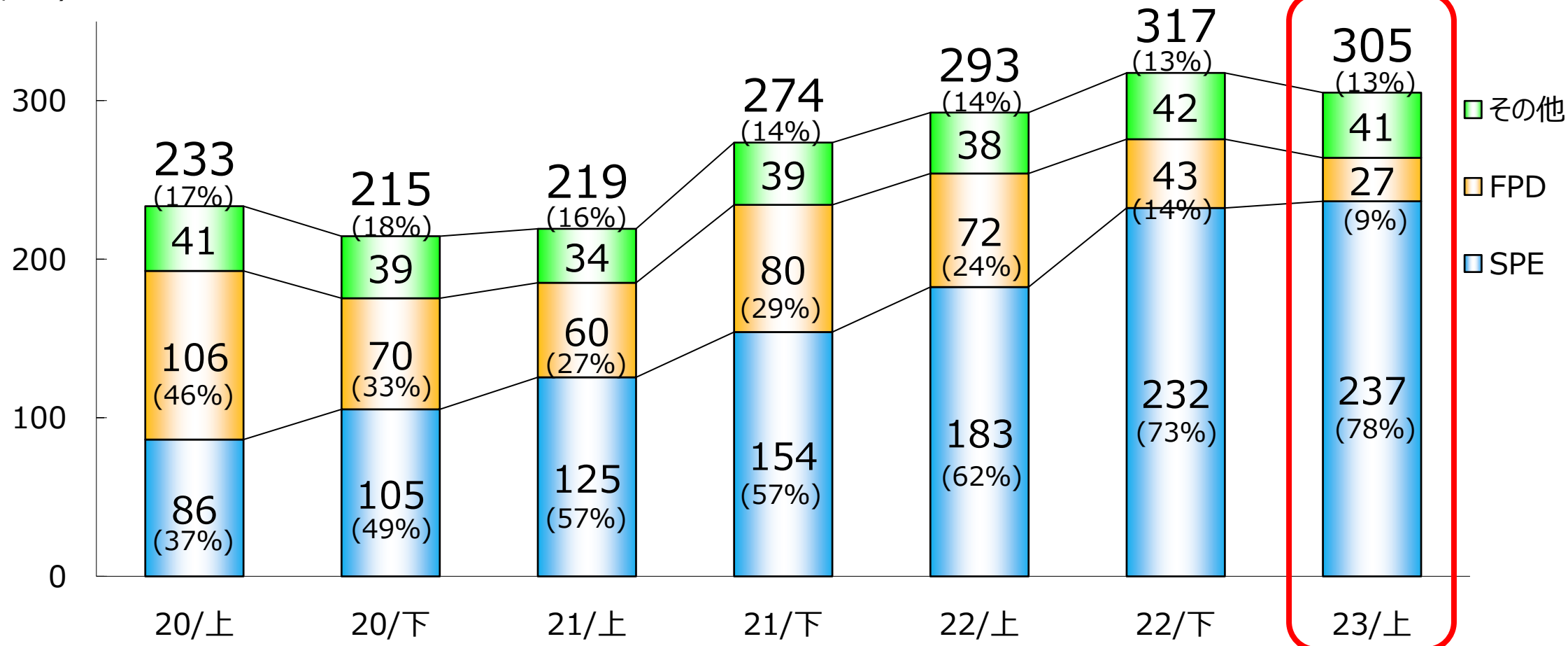


## 分野別売上高

SPE分野 78%

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

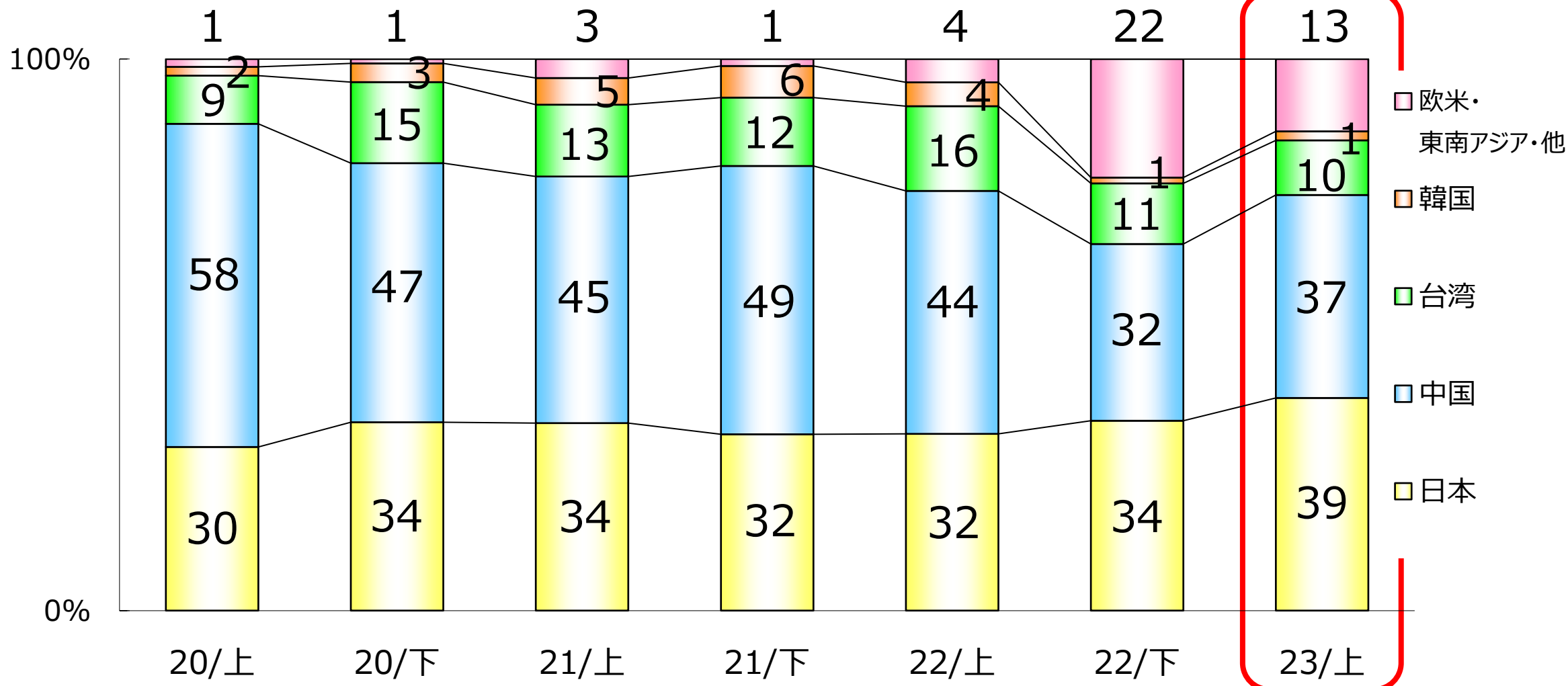
(億円)



## 地域別売上高比率

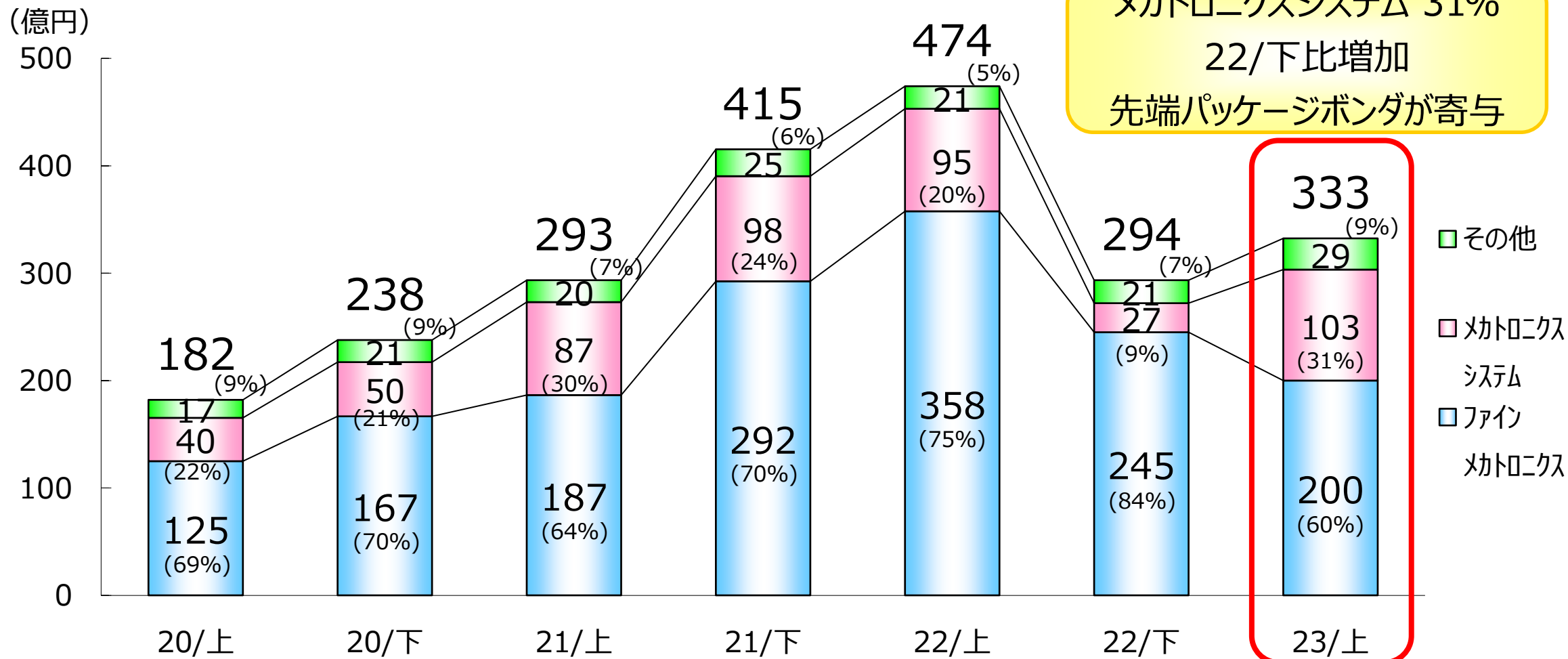
海外向け61% (中国37%)

\* 仕向地で区分



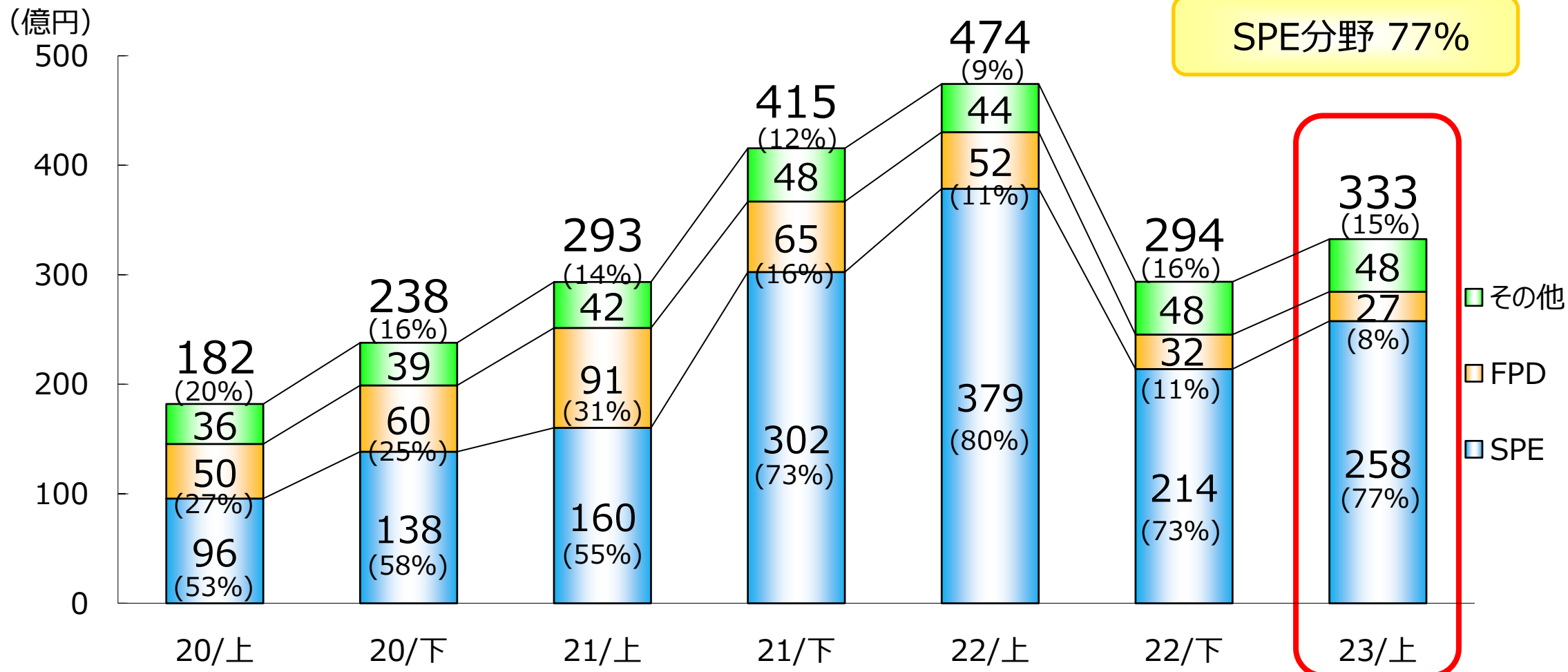
## セグメント別受注高

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



## 分野別受注高

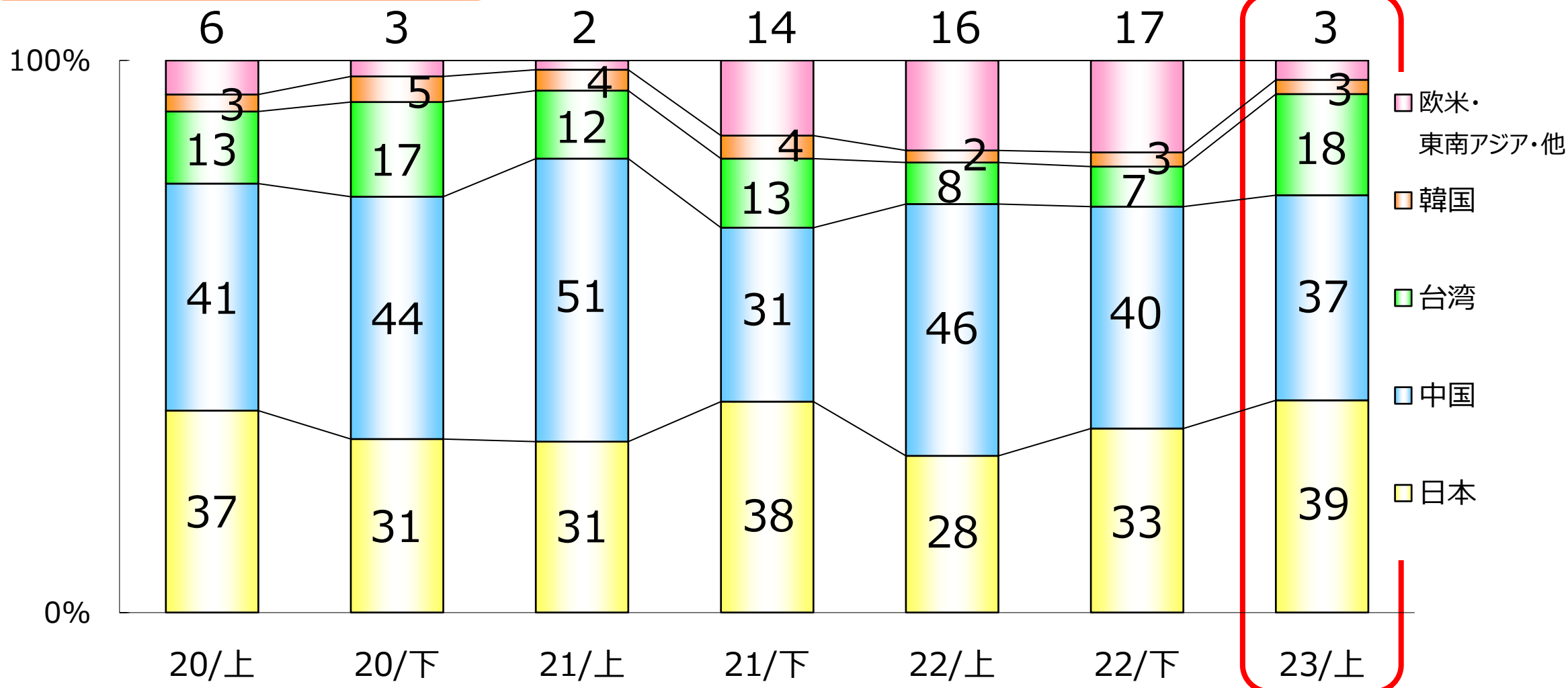
\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置



## 地域別受注高比率

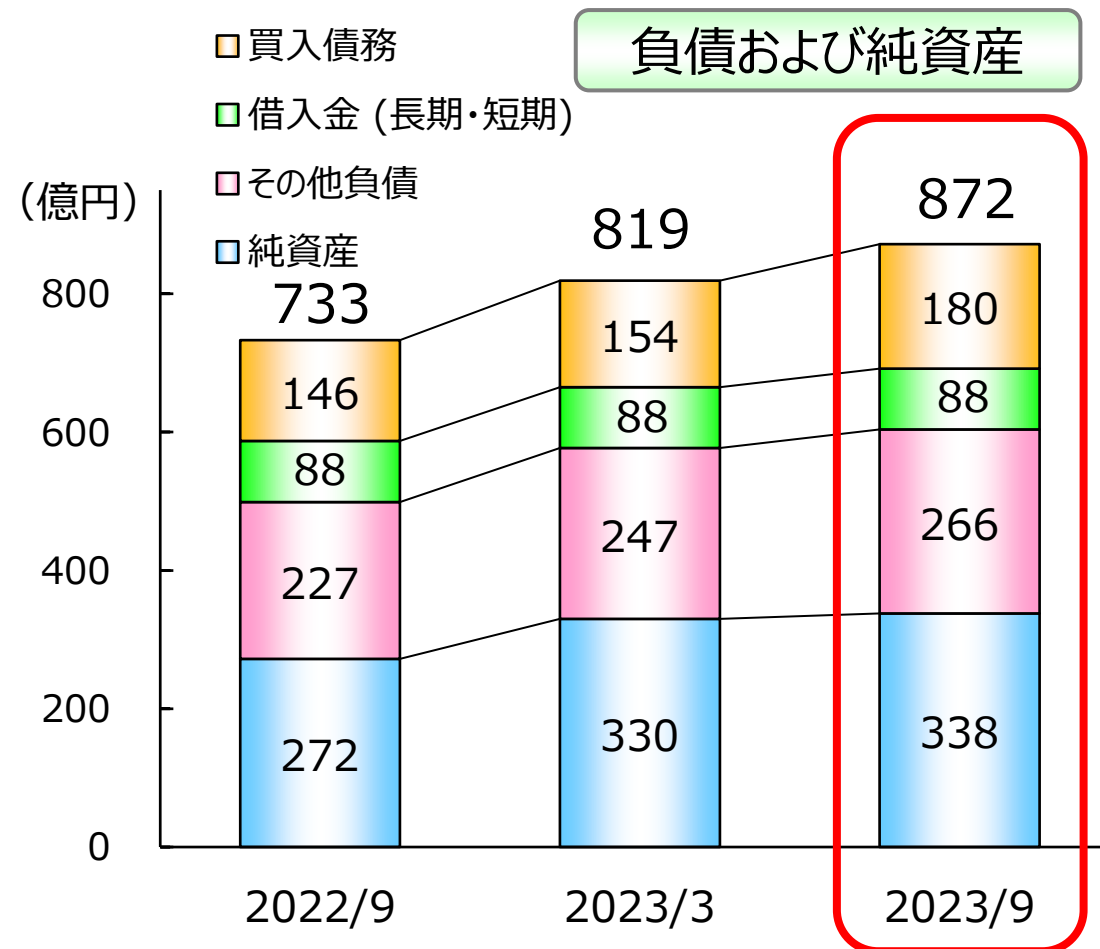
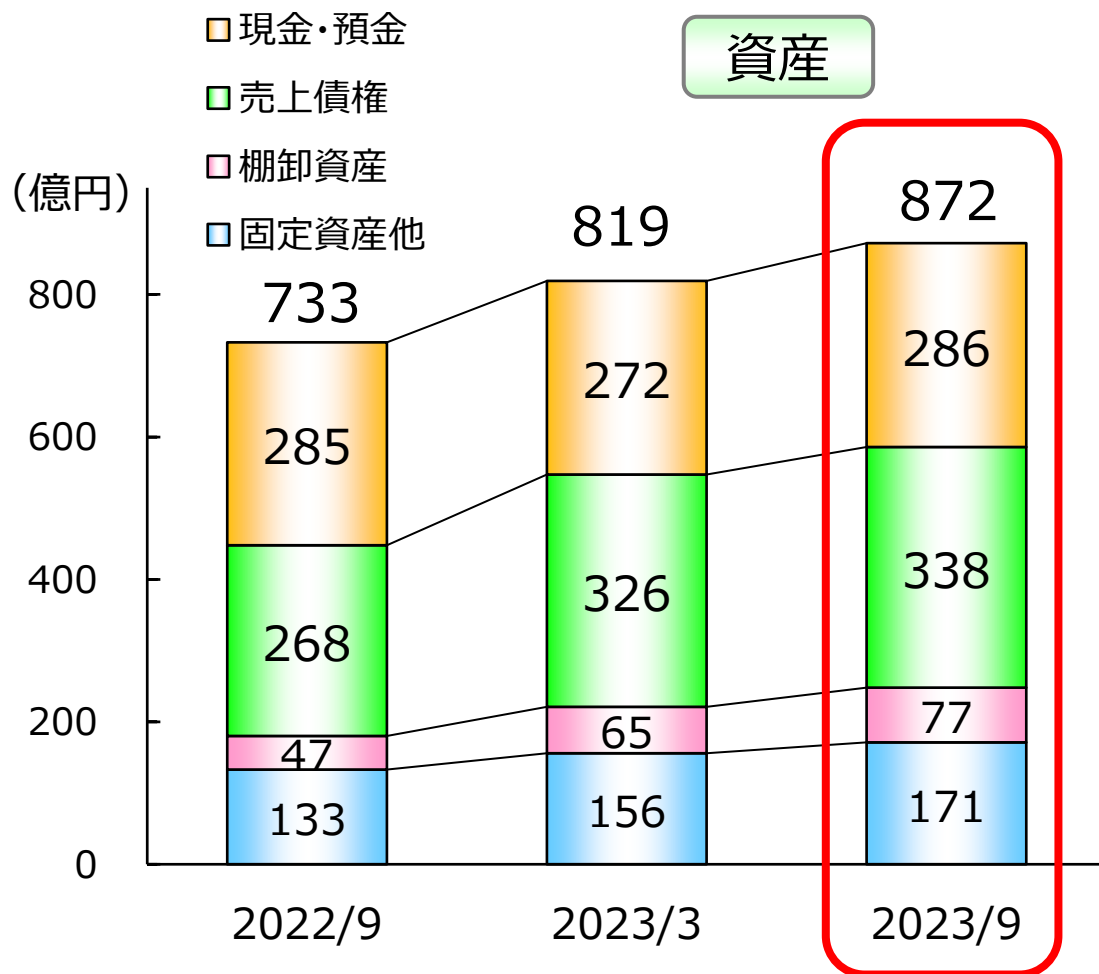
海外向け61% (中国37%)

\* 仕向地で区分



## 貸借対照表

自己資本比率 40% ('23/3) → 39% ('23/9)  
 D/Eレシオ 0.27倍 ('23/3) → 0.26倍 ('23/9)



## 目次

1. 2024年3月期 第2四半期 連結業績
- 2. 2024年3月期 連結業績予想**
3. 中期経営計画の進捗



## 業績予想サマリー

### ■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、スマホやPCなど需要が低調で設備投資は全体的に減速。生成AI向けの投資は活発。中長期的には市場拡大が期待される。  
FPD業界は、設備投資の減少傾向が当面続く見通し。

### ■ 通期業績予想

- 2023年度業績は、SPE分野の売上増加などにより前回予想から増収増益見込み

売上高	590億円	⇒	650億円 (前回予想比+10%)
営業利益	73億円	⇒	100億円 (前回予想比+37%)
ROS	12.4%	⇒	15.4% (前回予想比+2.7pt)
配当	120円	⇒	165円 (前回予想比+45円)

# 2023年度 業績予想 (2)

## 業績予想

前回予想から売上高、利益とも  
上回る見込み

\*1: 2023年8月公表

(単位: 億円)

	2020 年度	2021 年度	2022 年度			2023 年度 予想		前回予想 *1		2023 年度	
			22/上	22/下	23/上 実績	23/下 見通し	23/上 見通し	23/下 見通し			
売上高	448	493	293	317	610	305	345	650	290	300	590
営業利益	29.6	50.5	46.0	63.1	109.1	50.2	49.8	100.0	40.0	33.0	73.0
R O S	6.6%	10.3%	15.7%	19.9%	17.9%	16.4%	14.4%	15.4%	13.8%	11.0%	12.4%
経常利益	28.2	48.8	42.6	62.6	105.1	50.3	46.7	97.0	39.0	28.0	67.0
当期純利益	19.7	29.8	34.1	57.9	92.0	38.7	33.3	72.0	31.0	21.0	52.0
R O E	9.5%	12.8%	-	-	31.9%	-	-	20.5%	-	-	15.0%
F C F	74.1	77.9	43.8	-11.9	32.0	46.3	-45.0	1.3	-	-	30.0

## 配当予想

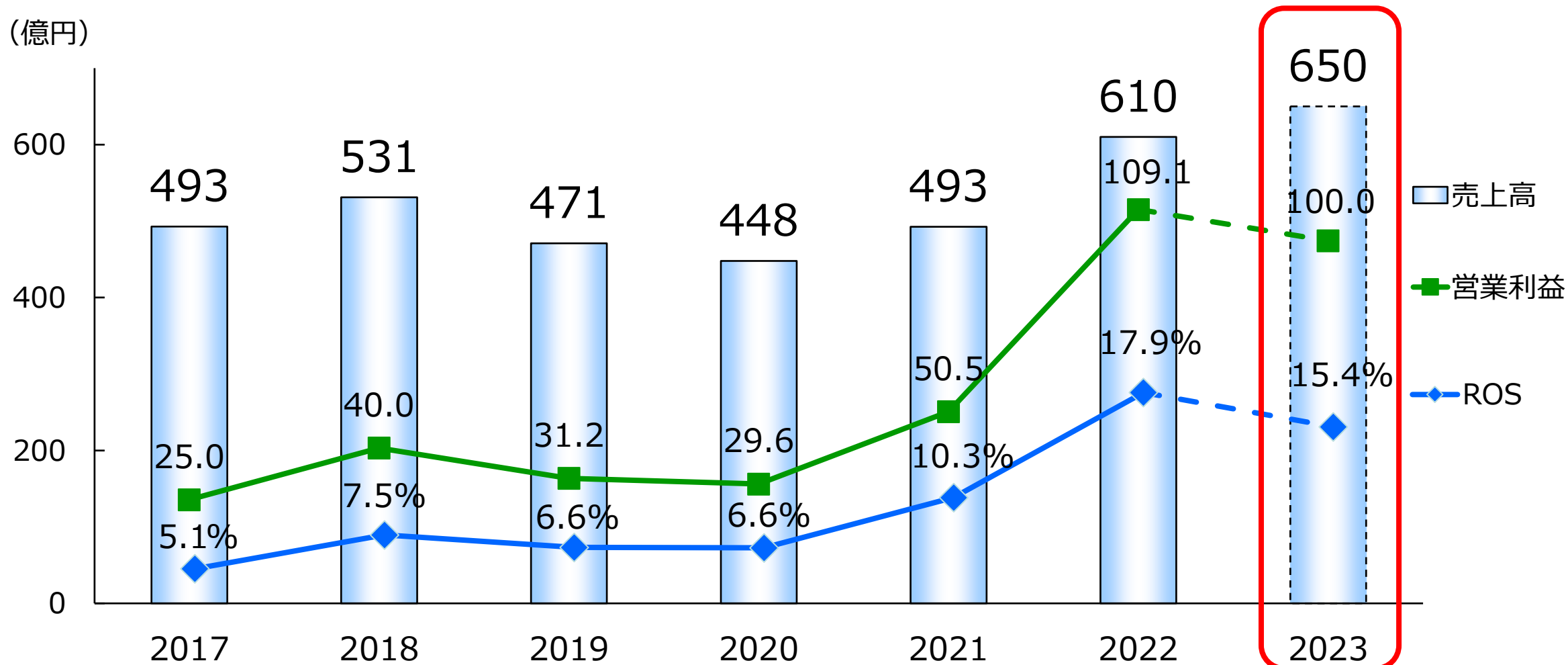
当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。  
 2023年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は45円増配の  
165円 (配当性向 30.1%) を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想 (2024年3月期)	0円	165円	165円
前回予想 (2024年3月期)	0円	120円	120円

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で株式分割を実施後の金額  
 株式分割前の算定では配当495円に相当

## 売上高・利益・ROS

(億円)



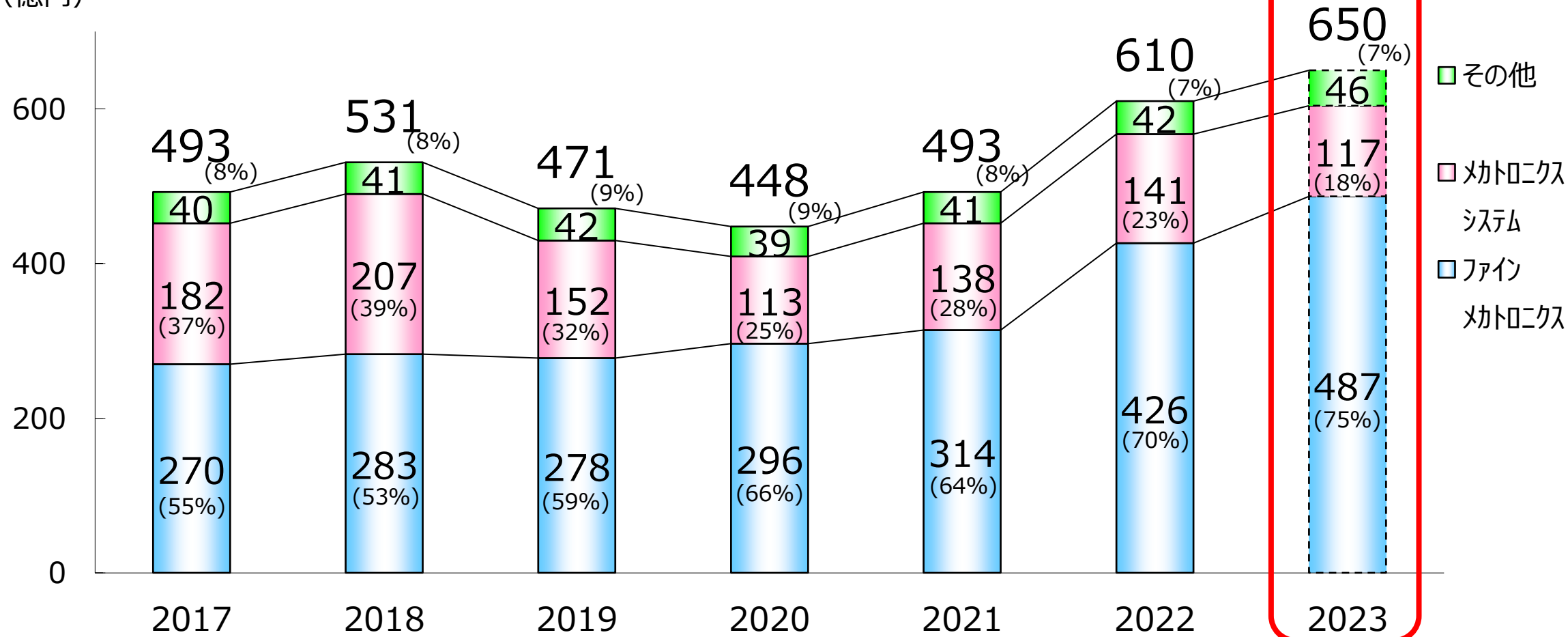
# 2023年度 業績予想 (5)

## セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 75%

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

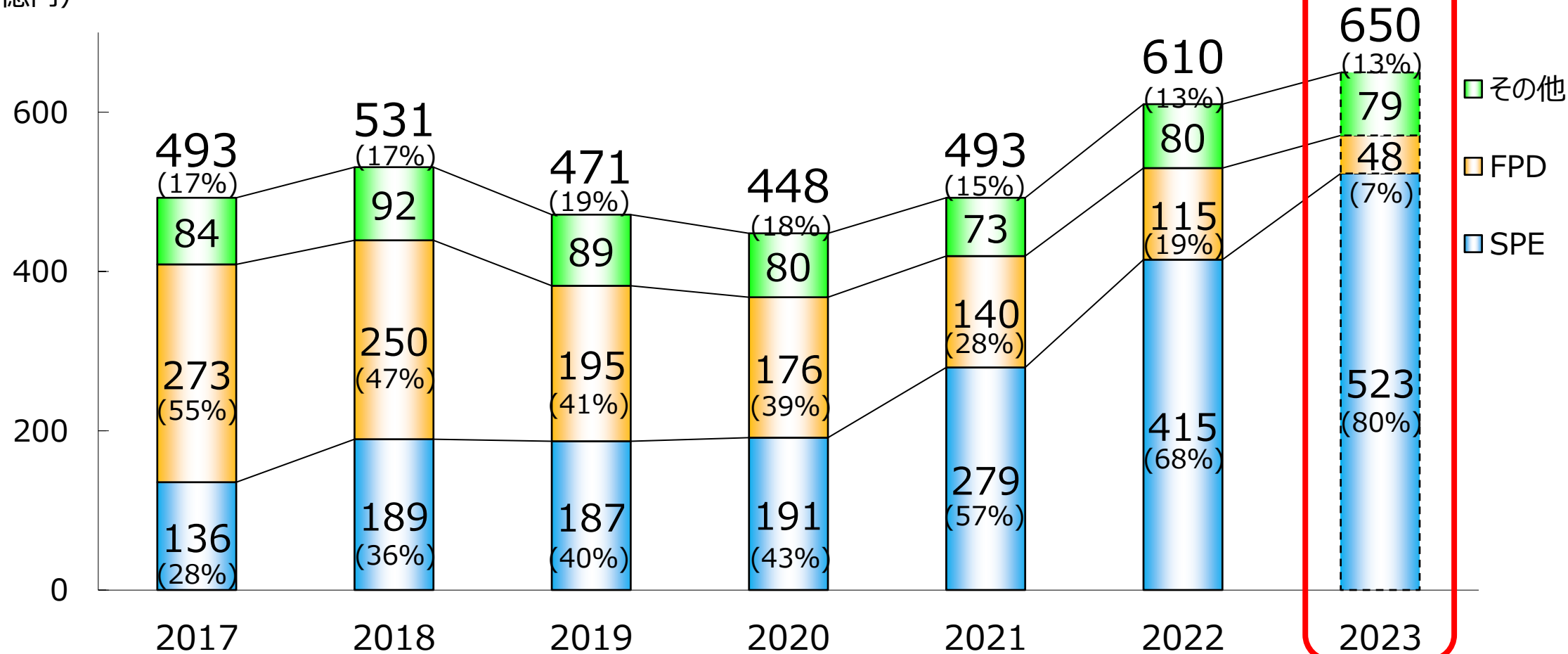


## 分野別売上高

SPE分野80%に拡大

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)



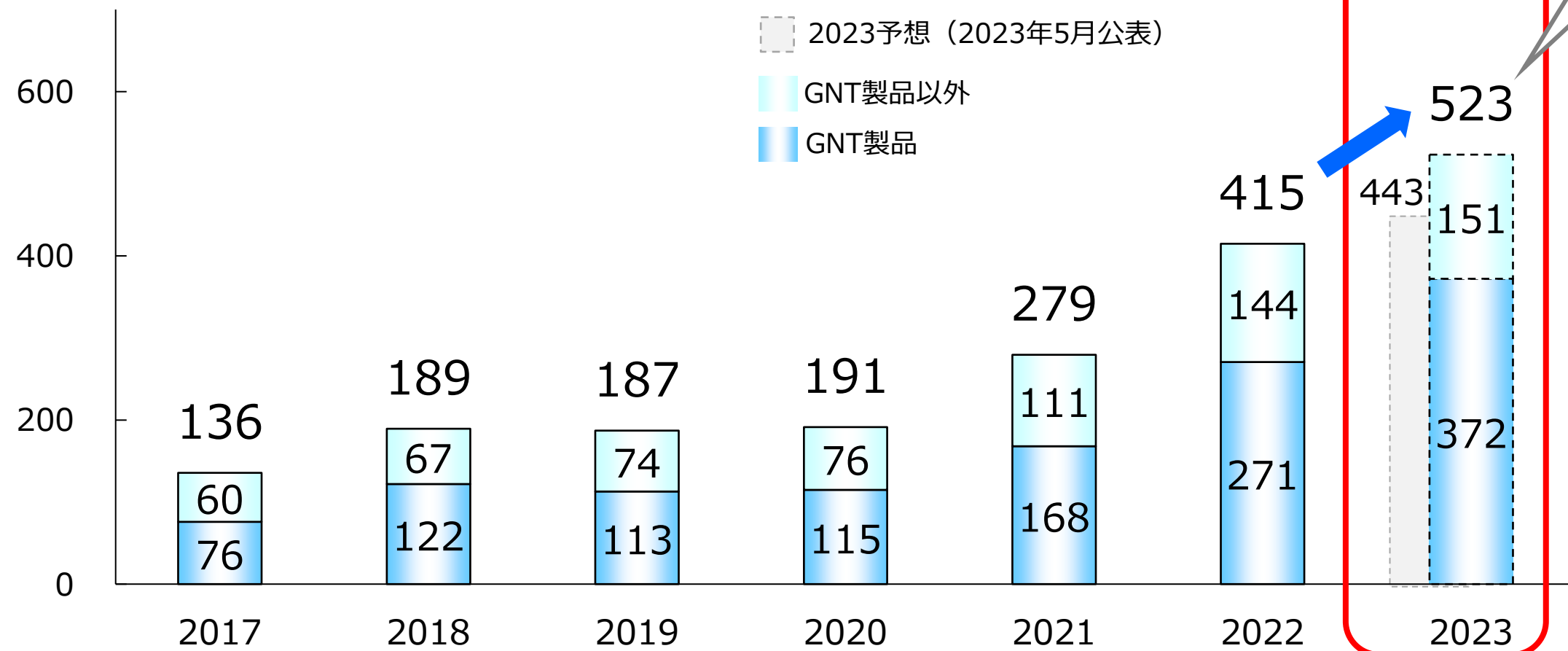
# 2023年度 業績予想 (7)

## SPE分野売上高

2023年度は5月予想を上回る見込み

\*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ 対象製品群 (cf.p.31)

(億円)

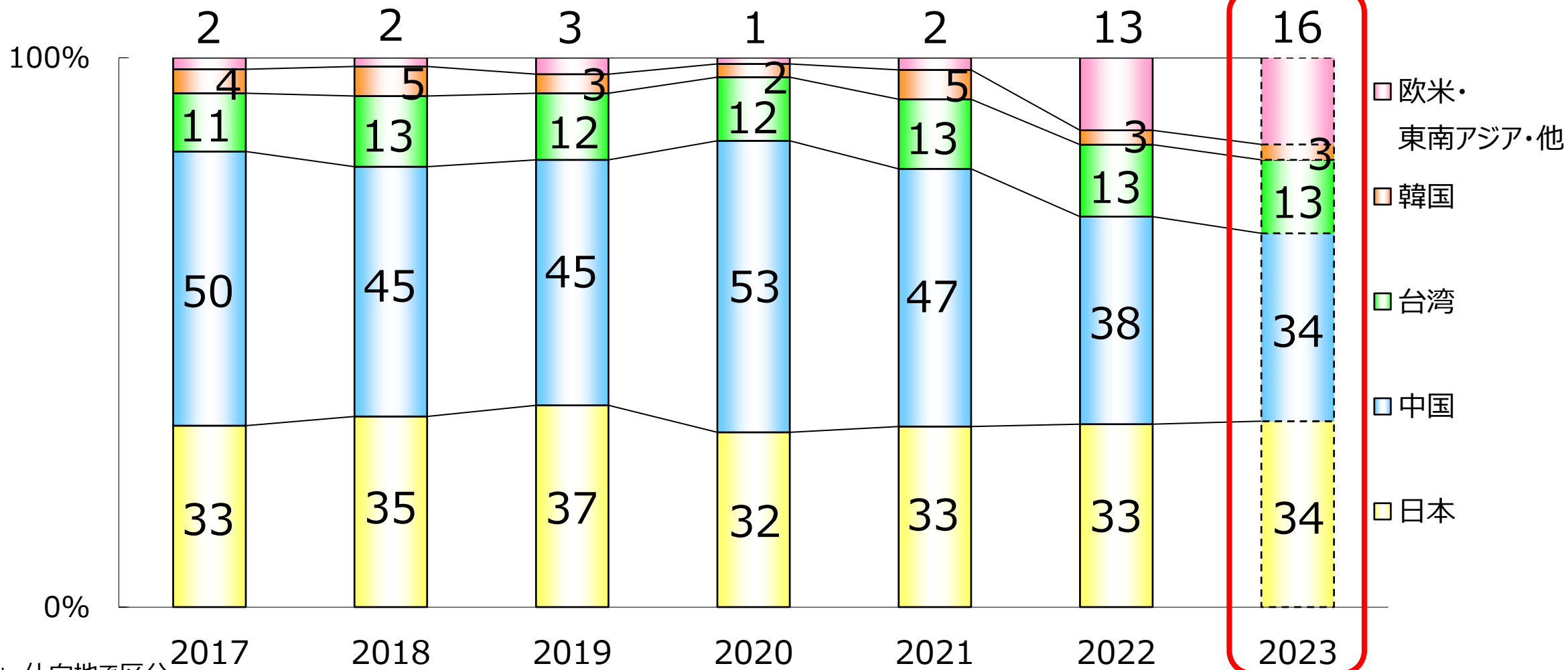


SPE全体  
売上高

# 2023年度 業績予想 (8)

## 地域別売上高比率

海外向け66% (中国34%)  
欧米・東南アジア・他が増加



\* 仕向地で区分



## 目次

1. 2024年3月期 第2四半期 連結業績
2. 2024年3月期 連結業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**

## 当社として捉える社会変化・課題

### 市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

### 技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

### 環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

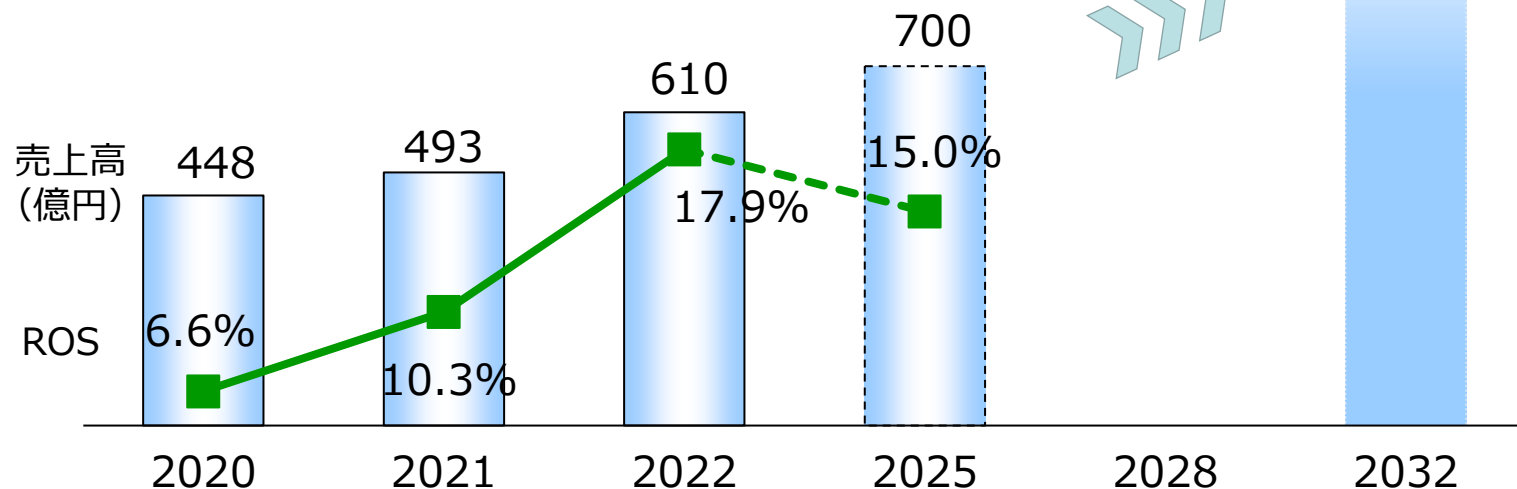
### 安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

## 10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して  
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で  
 ・売上高1,000億円以上  
 ・ROS20%以上  
 を目指す



# 中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

芝浦ビジョン2033達成

**2023-2025  
芝浦ビジョン2033  
Phase.1**

2026-2028  
芝浦ビジョン2033  
Phase.2

2029-2032  
芝浦ビジョン2033  
Phase.3

「持続的成長に向けた投資」を柱として、  
次の成長に向けた土台強化を進め  
再び営業利益100億円超を目指す

## <2025年度目標>

売上高	700億円
営業利益	105億円
ROS	15%
ROE	17%

4  
つ  
の  
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

# 中期経営計画進捗 (1)

## 中期経営計画の進捗

2023年度は中計目標の  
売上・利益を上回る予想

\*1: 2023年5月公表

単位：億円

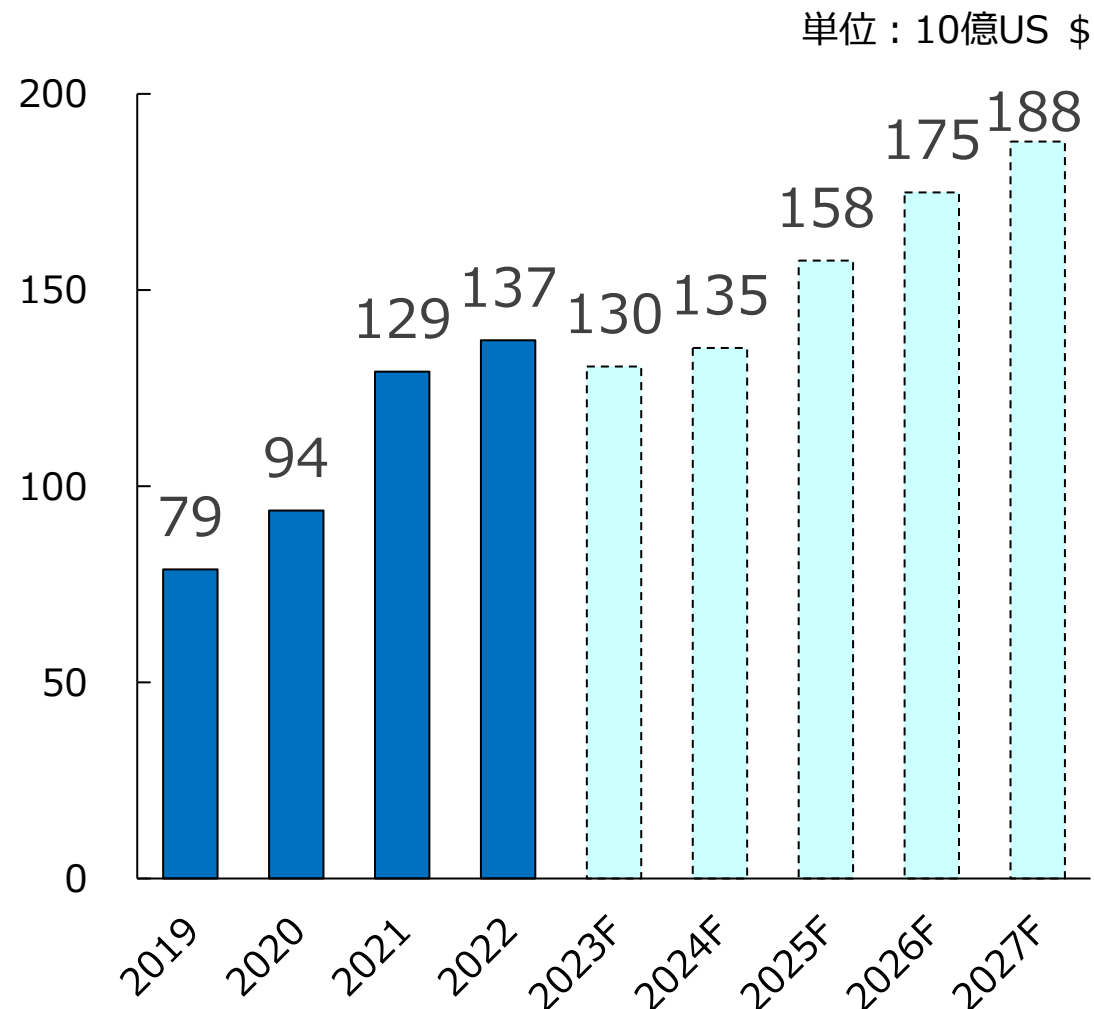
	2021	2022	2023	中期経営計画年度目標 *1		
	年度実績	年度実績	年度予想	2023	2024	2025
売上高	493	610	650	590	680	700
営業利益	50.5	109.1	100.0	73.0	95.0	105.0
R O S	10.3%	17.9%	15.4%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	48.8	105.1	97.0	-	-	-
当期純利益	29.8	92.0	72.0	-	-	-
R O E	12.8%	31.9%	20.5%	15.0%	17.0%	17.0%

## 当社の事業環境 (全体感・SPE)

- スマホ、PC、TVの需要は低調な状態が継続し設備投資は全体的に減速
- 半導体輸出規制強化は継続注視が必要だが、IoT、5G、AIなど底堅い需要を基調に引続き中長期的な半導体市場拡大が期待される
- 現在の当社の事業環境は、受注面からみると
  - SPE前工程** 市場は一時的に減速するがファウンドリ、パワーデバイス、Siウェーハ、いずれも中期的に投資継続
  - SPE後工程** 生成AI用途の2.5DおよびFO-WLPパッケージ向け投資が活況
  - ハイブリッド接合に対する市場の関心は依然高い

\*出典：TechInsights Manufacturing Analysis Inc., 2023-10、当社にてグラフ作成

■半導体製造装置 売上高予測\*



## 当社の事業環境 (FPD)

➤ 同様にFPDも受注面からみると

**FPD前工程** パネル全体の需要減と供給過剰により設備投資の減少は当面続く見通しだが、大型サイズOLED (ITパネル他向け) の投資に期待

**FPD後工程** TVパネルの需要減少により設備投資が停滞

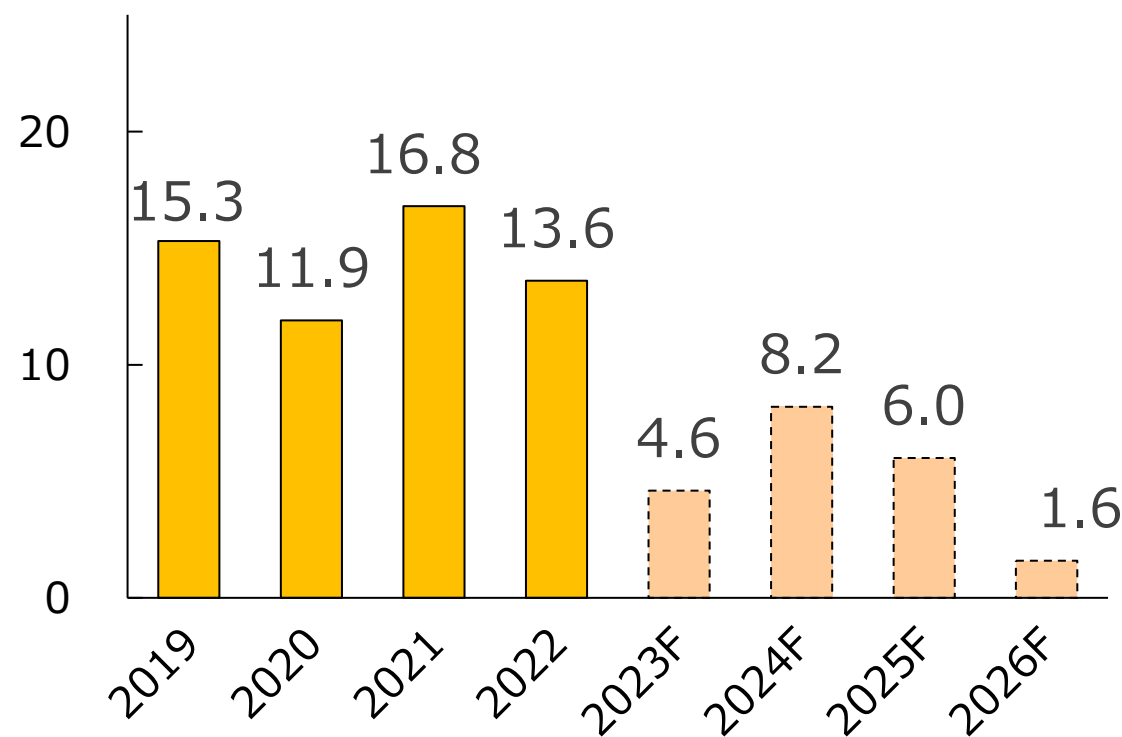
車載パネルは大型化の検討が進むも投資は慎重

ITパネルは新型コロナ特需からの反動要因で冷え込んでいた設備投資の回復に期待

\*出典：Display Supply Chain Consultants, LLC, 2023-8、当社にてグラフ作成

■ FPD製造装置 売上高予測\*

単位：10億US \$



## SPE分野工程別 主要製品群

### Siウェーハ製造

枚葉式Siウェーハ  
洗浄装置



### フォトマスク製造

マスク  
エッチング装置

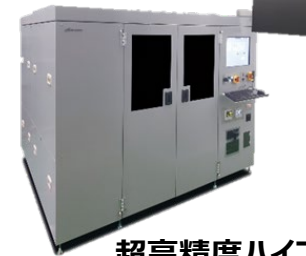


マスク洗浄装置



### モジュールプロセス

高精度2.5Dボンダ



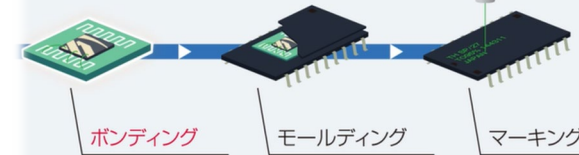
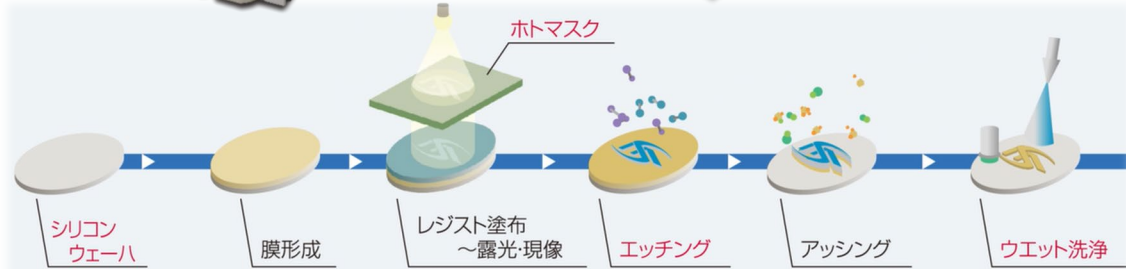
超高精度ハイブリッドボンダ



高精度Fo-PLPボンダ



\* 当社グローバル ニッチトップ  
対象製品群 (GNT製品)  
が属す4工程  
(掲載機種は一例)



### その他の注目製品



ケミカルドライエッチング装置

### ウェーハプロセス



枚葉式リン酸  
エッチング装置

### 新しいGNT製品

創出・拡大に  
注力

- 引き続き4工程の製品群を  
GNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野  
の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出

## SPE前工程トピックス

### Siウェーハ製造

- 当社独自の最新洗浄技術をSiウェーハ洗浄プロセスに展開
- 25年の上市を目指し基礎評価を開始



枚葉式Siウェーハ洗浄装置

### フォトマスク製造

- ドライエッチング装置は次世代EUV対応とレガシー製品でシェアアップ
- 洗浄装置は24年に凍結洗浄技術搭載の新機種を上市予定



マスクエッチング装置

### ウェーハプロセス

- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は新加熱方式を先端ロジック製品で評価開始
- メモリメーカーへのリン酸プロセス適用で更なるシェアアップを狙う



枚葉式リン酸エッチング装置



## SPE後工程トピックス

### モジュールプロセス



高精度2.5Dボンダ  
**TFC-6500**

- 2.5D、3Dパッケージを見据えた高機能ボンダ
- 生成AI向けGPU市場でも高評価、多くの受注を獲得中



高精度Fo-WLPボンダ  
**TFC-6100W**

- アプリケーションプロセッサをはじめ、高密度Fo-WLP市場で豊富な実績
- シリコンブリッジを想定した次世代ボンダを開発、23年末上市予定



超高精度ハイブリッドボンダ  
**TFC-6700**

- 生産性を向上した後継機種TFC-6800が今年8月に上市
- 自社製前処理（洗浄、プラズマ）システムの研究開発が進行中



高精度Fo-PLPボンダ  
**TFC-9300**

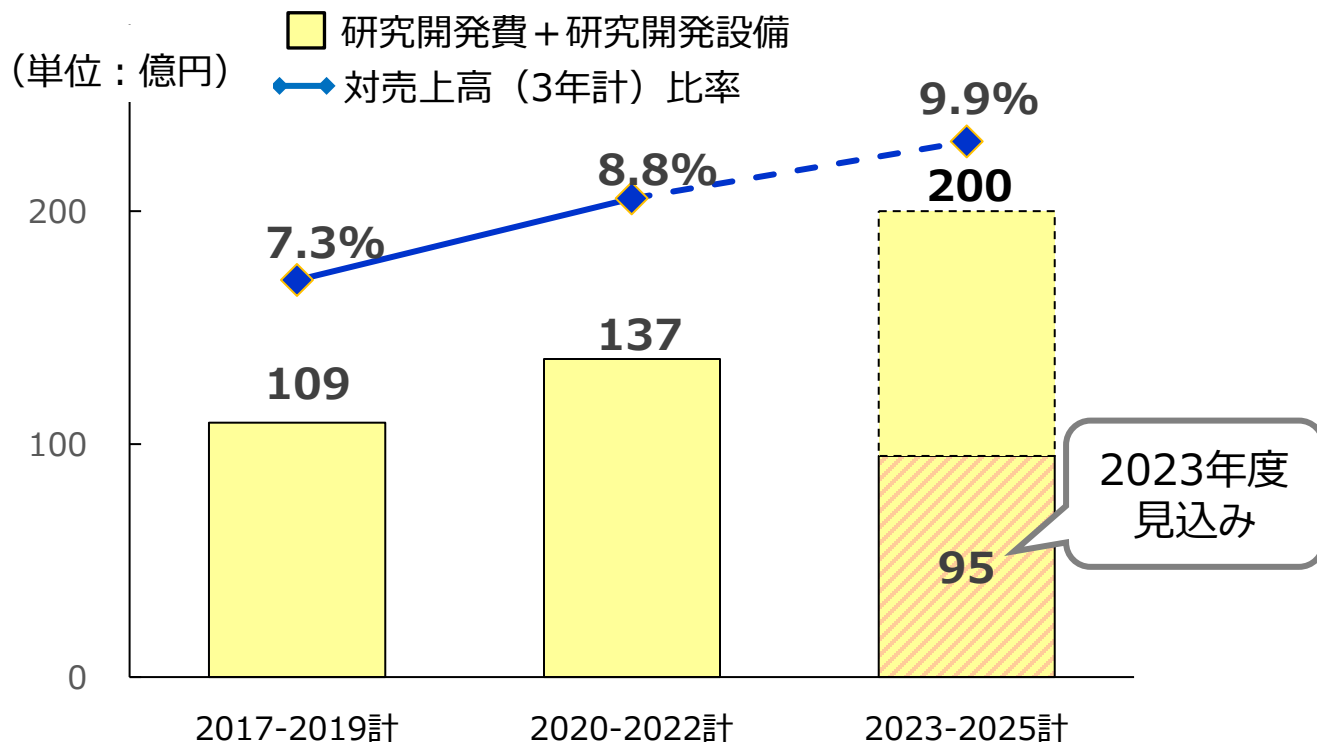
- Fo-PLP市場のさらなる成長拡大をモジュールプロセスから牽引
- 大型基板へ高精度で実装、高い技術力と実績で基板実装分野へ進出

## 持続的成長に向けた投資

### ■ 研究開発費・研究開発設備

➢ 中計計画に沿いSPE分野中心に実行中

### ■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移 (中計期間別)



### ■ 建屋整備 (横浜事業所、さがみ野事業所)

➢ クリーンルーム増設に向け計画どおり進捗中  
(投資総額約70億円)

### ■ 横浜事業所 研究開発新棟 (2025年夏 竣工予定)



(3階建て、延床面積 約4,300m<sup>2</sup>)

## サステナビリティ経営関連トピックス

- 国連グローバル・コンパクト（UNGC）へ署名
  - 国連と民間（企業・団体）が手を結び、健全なグローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティイニシアチブであるUNGCへ署名、参加企業として登録
  - 「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の防止」の4分野・10原則を支持、実践し、マテリアリティ達成に向けた取組み加速に繋げる
  
- 統合報告書2023発行
  - 従来のアニュアルレポートとCSR報告書を統合
  - 当社グループの中長期的なビジョンや戦略を、一貫性のある価値創造ストーリーとして報告
  - 環境調和型製品の開発・提供を引き続き推進



統合報告書2023

# Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

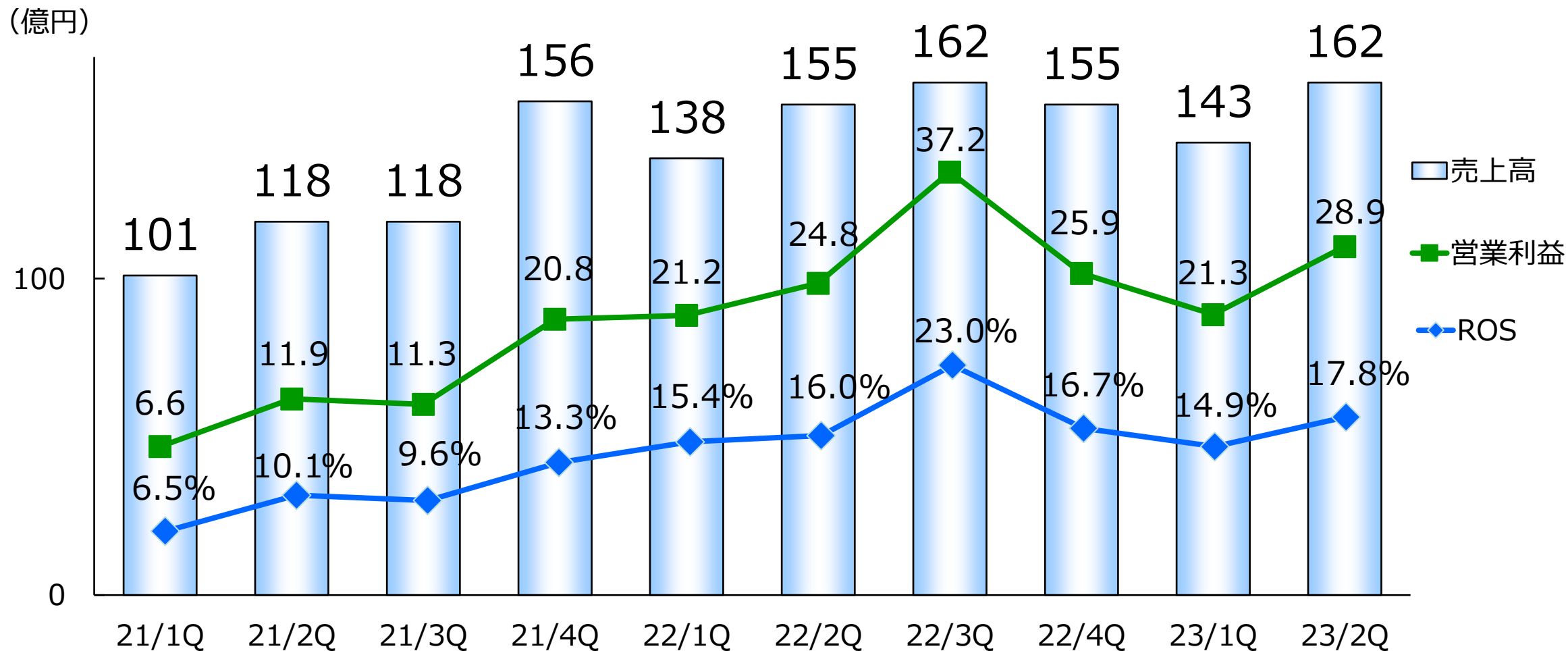
「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で  
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

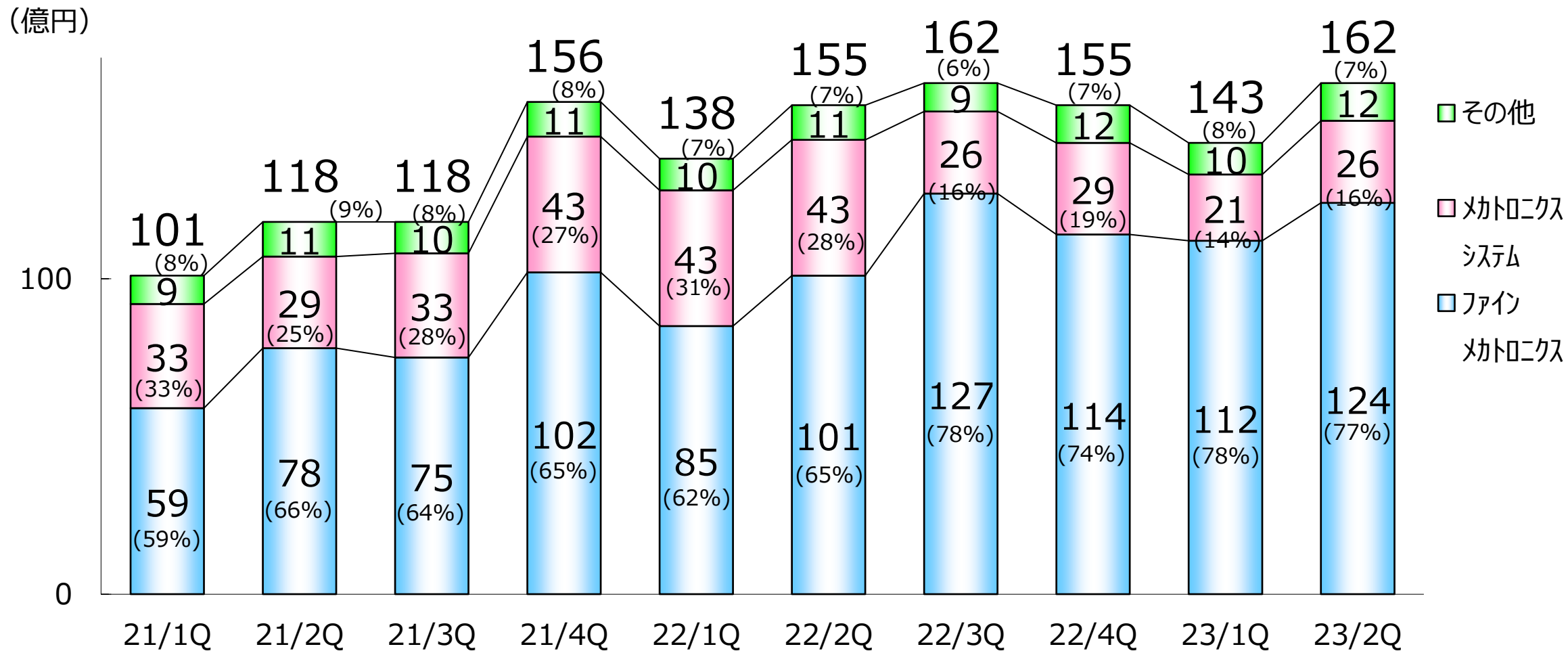
# Appendix

## 売上高・利益・ROS



## セグメント別売上高

\* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
 エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

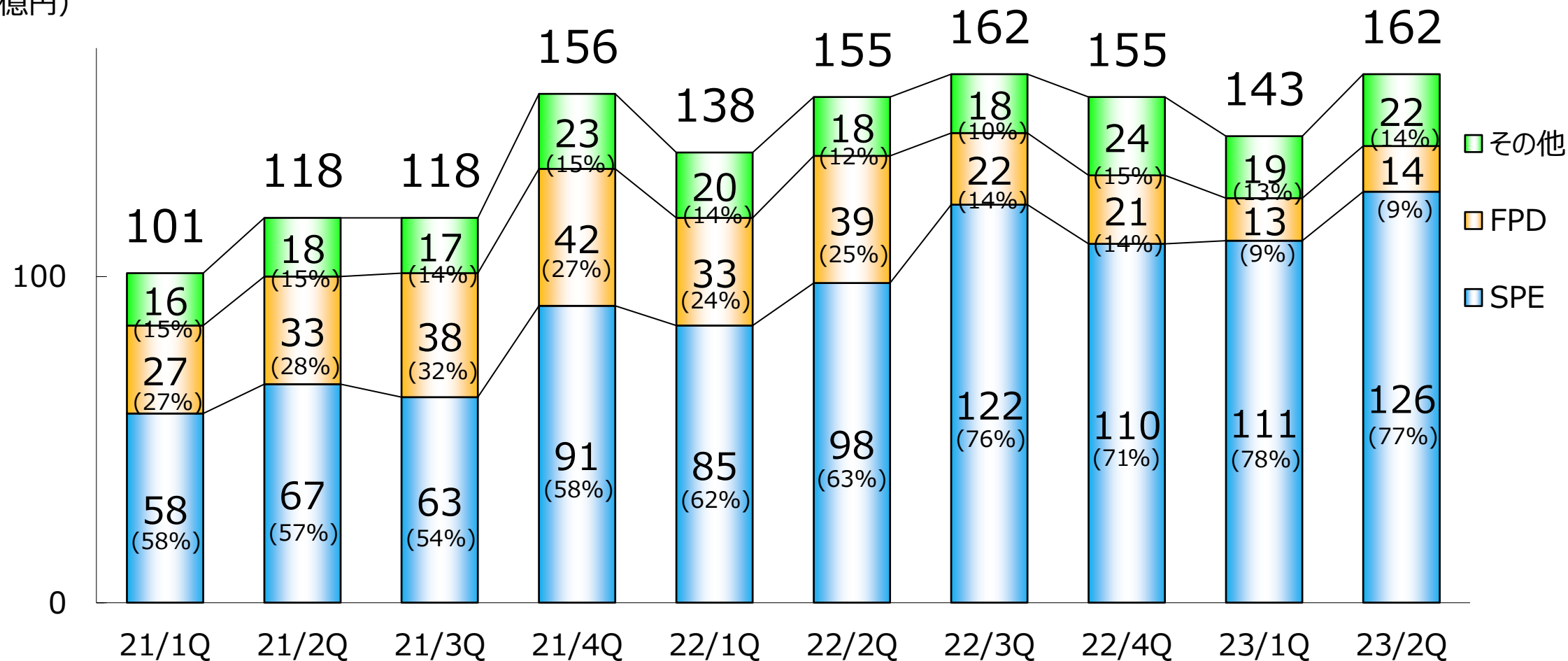




## 分野別売上高

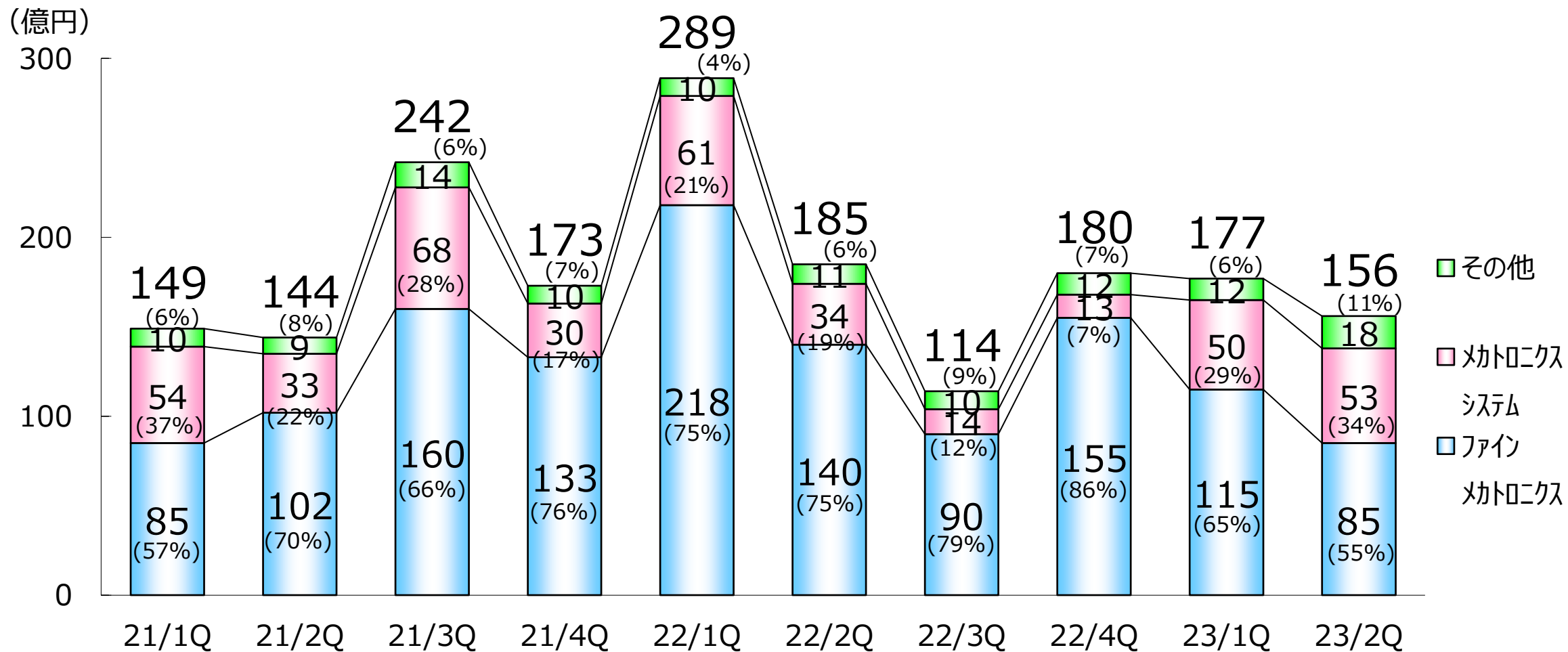
\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置

(億円)



## セグメント別受注高

\* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置  
メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



## 分野別受注高

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置

